

深圳市江波龙电子股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	Citi Research、Artisan Partners、Capstone Fund、FENGHE FUND MANAGEMENT PTE LTD、Fidelity International (FIL)、MANULIFE ASSET MGMT ASIA 、Perseverance Asset Management L.L.P、Pictet AM、Point72 Asset Management、POLYMER CAPITAL MAN (HK)、Rays Capital Partners Ltd、Temasek Holdings (Private) Ltd、TRIVEST ADVISORS、Value Partners、Nikko AM、申万证券、诺安基金、云图资产、怀远基金、招商资管、唯德投资、凯丰投资、东海证券、SPARX 资管、长城证券、信达澳亚
时间	2024年5月27日（周一）下午 11:00~12:30 2024年5月27日（周一）下午 15:00~16:30 2024年5月29日（周三）上午 10:00~11:30 2024年5月31日（周五）上午 11:30~12:30 2024年5月31日（周五）下午 15:30~16:30
地点	深圳市南山区科发路8号金融基地1栋8楼会议室

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书 许刚翎 投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1、从下游领域来看，公司在各细分市场营收分别占比多少？</b></p> <p>答：目前公司暂未对各下游细分市场营收进行统计。从公司四大产品线来看，今年嵌入式存储业务依然是公司主力，是销量及毛利的主要贡献来源；典型的移动存储业务将保持稳定的业务占比；基于公司企业级存储产品的推出，叠加信创行业复苏所带来的双重驱动，今年公司固态硬盘业务占比将呈现稳步上升的趋势；最后是内存条业务，今年其营收占比预计保持稳中有升。</p> <p><b>2、公司对未来晶圆价格走势的判断？</b></p> <p>答：依据市场机构分析，目前原厂供应向企业级产品倾斜，整体存储晶圆的供应依然偏紧；其次，在价格上，原厂拉涨价格的态度目前较为坚决，今年内晶圆价格有望延续温和上涨的趋势，但各个不同应用场景下的存储器价格趋势可能出现结构化差异。各厂商之间的技术能力、市场能力及品牌能力等差异化要素的作用权重有望增大。</p> <p><b>3、目前公司自研主控及封测业务对比外采或外协的优势有哪些？</b></p> <p>答：公司两款自研主控芯片（WM 6000、WM 5000）已经批量出货，赋能公司 eMMC 和 SD 卡两大核心产品线，并已经实现了数千万颗的规模化产品导入，助力公司中高端存储器产品固件算法自研的竞争优势，进一步增强公司整体竞争力以及产品技术护城河；</p>

封测制造方面，公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力，并于 2023 年完成了元成苏州和 Zilia 的并购，这是加强全球供应链布局，进一步开拓海外市场的重要举措，有助于公司形成全球化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造格局。

#### **4、公司在信创行业进展情况？**

答：公司重视并投入信创产业，对党政信创、行业信创并重。在党政信创领域，公司主要与浪潮、深信服等下游大客户积极配合。在行业信创领域，目前看到以电信运营商为代表的部分行业信创市场有所起色，预计今年会有更多新增需求。信创市场对应公司的主力产品线集中在企业级存储业务，由于行业信创涉及到每一个采购主体各自的采购程序，包括采购程序之前的产品验证导入的过程，因此在前两年企业级产品完成验证程序的基础之上，公司未来在信创行业将迎来更多的参与机会。公司企业级存储业务在今年预计会有一定受益。

#### **5、国产替代为公司带来的机遇有哪些？**

答：未来存储行业的国产替代刚需，公司认为将更多的体现在行业信创服务器存储领域。在产品形态上，表现为企业级存储产品，如 eSSD、RDIMM 产品。企业级存储具备技术壁垒较高，产品导入验证周期长、竞争者进入难度大等特点，公司近年来投入了大量研发资源。随着公司 eSSD、RDIMM 产品的量产出货，代表着公司在企业级存储这一关键市场取得了新的进展，将为公司业绩增长带来新的增量。此外，企业级市场除了国产替代领域外，其在海外市场亦具备一定的规模。因此公司除了立足国内市场，未来也将持续拓展海外市场，不断提升公司在全球的市场份额。

#### **6、公司目前的库存策略？**

答：公司采用以需求为基本牵引，结合市场综合因素判断的采购策略。公司 2024 年一季度营业收入 44.53 亿元，同比增长 200.52%，随着公司整体销售规模的不断增长，公司存货金额也会相应增加；与此同时，公司大客户有所新增（如 OPPO 等），大客户非常关注公司持续供应能力，公司相应增加备货；此外，从目前行业来看，参与各方（包括公司在内）均认为存储晶圆的价格在未来一段时间内将保持上涨的态势，公司存货的备货策略也会与下行周期有所差异。

#### **7、晶圆涨价对公司毛利率的传导效应？**

答：因晶圆采购与产品销售之间存在周期间隔，晶圆价格上行将对公司毛利率产生一定正面影响。公司 2024 年第一季度实现了 24.39%，目前公司毛利率已处在相对健康区间。公司毛利率变动受产品结构、上游原材料供应情况、存储市场需求波动、市场竞争格局变化等因素综合影响，公司将不断进行产品结构的优化，加大对高毛利产品的研发和投入。

#### **8、公司核心优势及今年业绩增长点主要有哪些？**

答：在核心技术方面，公司拓展了 SLC NAND Flash 等小容量存储芯片设计能力，并推进相较于典型存储器/模组企业，公司研发布局突破藩篱进入到集成电路设计领域，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户认可实现量产销售，代表着公司具备了从存储晶圆设计、生产端深入理解各类存储晶圆特性的能力。另一方面，公司已经推出了 eMMC 和 SD 卡主控芯片（已批量应用），并匹配自研固件算法的既有竞争力后，能够高效率满足客户，特别是大客户的产品性能要求，并且在售后服务故障解决等领域以自有能力帮助客户快速解决问题，从而最终建立起主营业务的进入壁垒，增加大客户黏性。

封测制造方面，公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力，并于 2023 年完成了元成苏州和 Zilia 的并购，这是加强全球供应链布局，进一步开拓海外市场的重要举措，有助于公司形成全球化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造格局。

品牌优势方面，公司拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。公司经过十多年的技术积累，打造了 FORESEE 品牌并在存储行业拥有良好的口碑；Lexar（雷克沙）是大陆地区为数不多的拥有高端消费类存储品牌的企业，在全球市场具有较高影响力。

供应链方面，公司凭借应用技术、产品设计和市场销售优势，帮助晶圆原厂快速实现晶圆的产品化；其次，公司与国内外主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司在下游市场的供应优势。

总体来说，公司未来将通过不断投入研发，改善及提升产品结构，在企业级存储、车规工规级存储以及 Lexar（雷克沙）品牌业务等主要领域取得进一步的突破。

#### **9、公司目前的市场策略？**

答：公司将保持较快的、差异化的销售节奏，一方面增强自我造血能力，保持备货与经营性现金流量之间的平衡，一方面充分的利用目前企业级存储、车规级存储等市场的结构性短缺以及价格接受度较高的情况，将中高端业务经营得更好，更稳。

#### **10、公司企业级存储业务进展及客户情况？**

答：公司是国内少有的 eSSD 和 RDIMM 两类产品协同发展的企业，其中公司 eSSD 已经在多个核心客户处完成了认证和量产，广泛应用于通信、金融、互联网等行业，并在多个客户处取得了极高的性能和质量评价；RDIMM 方面，公司已经完成了从 16G 到 96G 所有主流容量产品的布局。

未来国内企业级存储市场有望持续快速增长，公司将有效地捕捉并利用这一市场机遇，实现业务的飞跃性增长。目前公司企业级存储业务发展态势良好，亦是公司业绩增长新动能之一。

**11、未来公司在智能汽车市场会重点布局吗？**

答：智能汽车市场是公司未来发展重点之一。在新能源汽车的带动下，汽车智能化程度不断提升，高级驾驶辅助系统（ADAS）、汽车事件数据记录系统（EDR）对于车规级存储的发展将构成新的动能，车规级存储的整体市场规模将保持增长。根据市场机构预计，未来十年，单车存储容量将达到 2TB-11TB。根据美光科技发布的《车用存储大趋势白皮书》，随着自动驾驶、车载娱乐系统普及，车用存储市场规模将从 2021 年的 40 亿美元提升至 2025 年的 100 亿美元，复合增长率将达 28%。而到 2025 年车均搭载存储将达 16GB DRAM 和 204GB NAND，分别较 2021 年水平提高 3 倍和 4 倍。公司认为，若考虑 AI 应用在智能汽车落地带来的影响，未来几年车均搭载存储的标准有望超过目前的普遍预期。

截至目前，公司车规级 eMMC、UFS 已通过汽车电子行业核心标准体系 AEC-Q100 认证，并已经进入国内二十多家 Tier1 供应链体系。目前公司车规存储芯片在快速上升阶段，车规级 eMMC 产品，UFS 产品已经批量应用在整车中。

**12、公司如何去攻克企业级存储重点客户？公司提供什么方案对于客户来说是比较有吸引力的？**

答：在企业级存储领域，公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”设计和供应能力的企业，企业级存储产品已在多个行业领域获得认证并量产，产品兼容国产 CPU 平台服务器，适用于云计算、分布式存储、边缘计算等，满足市场对高性能、高可靠性存储解决方案的需求。

在公司的产品结构策略中，以 eSSD 为主力产品突破客户，以企业级存储产品组合为个性化供应优势，能够较好的满足服务器等复杂应用场景的需求。

**13、Zilia 目前主要有哪些业务？将来是否会拓展到除巴西外的其他市场？**

答：Zilia 的收购作为公司加大海外市场开拓的具体举措，公司将以自身的技术与产品设计方案为 Zilia 赋能，发挥 Zilia 贴近本地客户、自研技术、综合存储产品、本地制造的优势，为海外客户提供更优质的服务，扩大公司的海外市场份额，并为公司国际业务的中长期发展起到基础性作用。

**14、未来公司在业务出海方面的战略性目标？**

答：基于存储产业链和行业特征，公司在境外中国香港、中国台湾、美国、欧洲、日本等地设立有分支机构，形成全球化经营布局。随着半导体存储产业进入上行周期，存储产品价格持续上涨趋势一直延续至当前，短期来看，继续上涨的复苏趋势仍在，加上公司 2023 年收入规模占同期全球市场规模仍不足 2%，公司增长空间广阔。未来，公司将积极拓展海外市场，加快全球化布局，实现国内国际双循环。

**15、原厂与公司在终端市场业务的差异体现在哪些方面？**

答：原厂的经营重心集中在芯片设计与芯片制造等产业链前端环节，在产品应用领域投入资源时，追求大规模、高回报的行业和客户（如智能手机、个人电脑及服务器行业的头部客户），而对于碎片化明显的其他存储下游应用市场，则较难逐一投入资源匹配。所以，在存储原厂的目標市场和目标客户之外，存在着多元化的市场需求和大量未充分发掘的应用场景，这些需求创造了独立存储器厂

商生存发展的广阔空间。

**16、Lexar（雷克沙）业务近几年快速增长的原因？以及未来盈利能力如何？**

答：Lexar（雷克沙）在 2023 年的逆势增长，得益于在人才与组织优化、渠道建设、产品创新以及品牌推广等方面的不懈投入。在人才与组织优化方面，2023 年持续加大人才升级与组织优化的力度。通过构筑适合于 toC 消费品牌的组织体系，Lexar（雷克沙）完成了骨干团队的迭代，使团队更加年轻化、高素质化和专业化。这样的团队结构不仅大大提高了工作效率，还为公司的长远发展注入了新的活力。

在渠道建设上，Lexar（雷克沙）充分发挥了中国高效的供应链优势，并结合全球化渠道布局，实现了市场的快速扩张。在美国、欧洲、中东、澳洲等多个区域，Lexar（雷克沙）成功进驻了众多知名零售卖场，如 Costco、Fnac、BestBuy、MediaMart 等，同时在亚马逊等线上零售平台也取得了市场份额的提升，不仅提升了 Lexar（雷克沙）产品的市场覆盖率，还增强了品牌在全球范围内的影响力。

在产品创新及品牌推广面，Lexar（雷克沙）坚持以用户为中心的理念，聚焦真实用户使用场景，通过用户思维引领产品定义和创新。Lexar（雷克沙）在 2023 年进一步大力投入品牌推广。通过明星产品营销、头部媒体传播、全球顶级展会、线上电商营销、头部品牌联合等多种方式，成功提升了各区域品牌知名度与关注度，持续增强消费者对 Lexar（雷克沙）品牌的认知度以及提升品牌在高端市场的竞争力。

**17、公司在东南亚是否有相关投资或业务？**

答：目前公司在东南亚地区主要以销售业务为主，如



	<p>公司部分产品会在东南亚 Shopee 等电商平台上进行销售，公司暂未在该地区进行大规模投资。</p> <p><b>18、公司未来是否会开展 HBM 相关业务？</b></p> <p>答：HBM 技术涉及到公司上游，即存储原厂内存芯片设计技术、晶圆级堆叠技术等不同环节的技术复合型应用，目前全球范围内的 HBM 产品技术应用均以存储晶圆原厂（如 SK Hynix，三星等）为主导甚至是存储原厂自行完成封装。目前公司子公司元成苏州具备晶圆高堆叠封装（HBM 技术涉及的一部分）的量产能力，但目前无法生产 HBM。</p> <p><b>19、未来 AI 技术对公司业务带来的增量？</b></p> <p>答：人工智能技术正推动数字经济和 AI 服务器的发展，公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”设计和供应能力的企业，企业级存储产品已在多个行业领域获得认证并量产，产品兼容国产 CPU 平台服务器，适用于云计算、分布式存储、边缘计算等，满足市场对高性能、高可靠性存储解决方案的需求。此外，公司的 DDR4、DDR5、SSD 产品有望在 AI 手机、AI PC 等轻量化 AI 市场广泛应用，同时公司也与客户就 AI PC、AI 手机保持密切沟通和合作。公司还布局了自研固件的 UFS 产品、自研存储芯片及晶圆级封装测试等业务，这些投入都为未来公司在人工智能加速发展下的快速增长打下基础。</p>
附件清单（如有）	无